

2.3次元パッケージ用基板 ~i-THOP®~

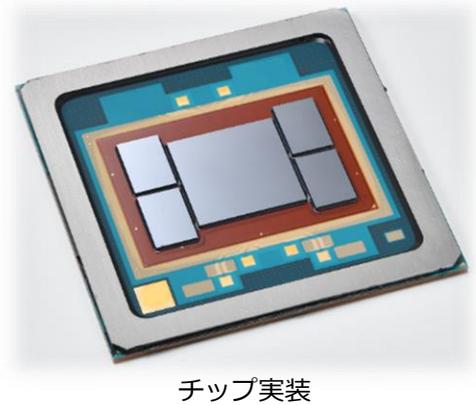
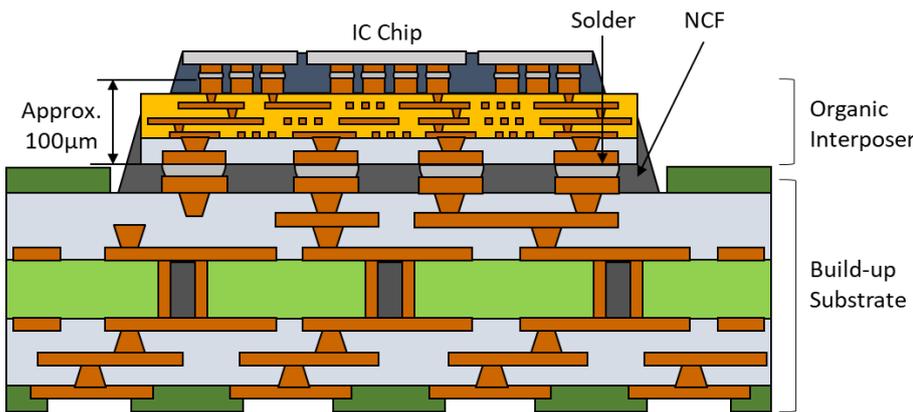
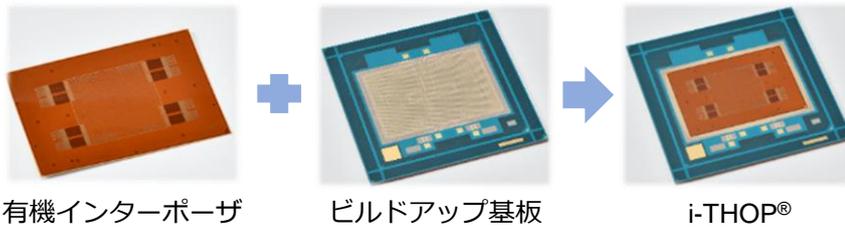
i-THOP (integrated Thin film High density Organic Package : アイソップ)。i-THOPは新光電気工業㈱の登録商標です。

- 開発中 -

特徴

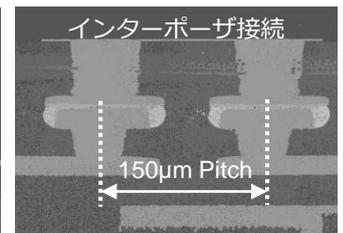
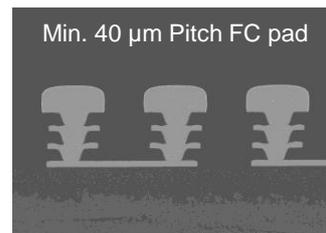
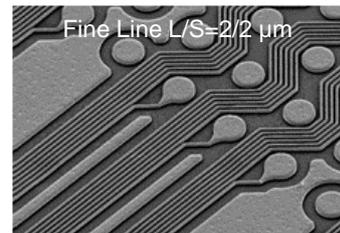
- ・ チップラストプロセスを実現する有機インターポーザとビルドアップ基板を一体化した高密度配線基板
- ・ インターポーザ部には薄膜技術を適用し、狭ピッチ配線と多数のI/O端子を形成
- ・ 異種チップ搭載、HBM (High Bandwidth Memory)等広帯域メモリーチップ搭載、チップレット集積などパッケージの大型化に対応可能なパネルプロセスによる製造

構造



技術

有機インターポーザ	
Min. FC (Flip-Chip) Pad Pitch	40 µm
Min. Line/Space	2 / 2 µm
Micro Via/Via Land Diameter	12 / 21 µm
Metal Thickness	2 µm
Insulation Thickness	5 µm
インターポーザ接続	
Material	Sn-Bi Solder
Solder Joint Pitch	150 µm



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

